

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】令和 3 年 11 月 25 日 (2021.11.25)

【公開番号】特開 2020-61449 (P2020-61449A)

【公開日】令和 2 年 4 月 16 日 (2020.4.16)

【年通号数】公開・登録公報 2020-015

【出願番号】特願 2018-191375 (P2018-191375)

【国際特許分類】

H 0 5 K 1/11 (2006.01)

H 0 5 K 3/46 (2006.01)

H 0 5 K 3/00 (2006.01)

H 0 5 K 3/40 (2006.01)

【F I】

H 0 5 K 1/11 H

H 0 5 K 3/46 N

H 0 5 K 3/46 Q

H 0 5 K 3/00 X

H 0 5 K 3/40 E

【手続補正書】

【提出日】令和 3 年 9 月 6 日 (2021.9.6)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 8】

【図 1】第 1 の実施形態に係る配線基板の構造を示す断面図である。

【図 2】導電層、充填材及び第 1 の配線層を示す断面図である。

【図 3】第 1 の実施形態に係る配線基板の製造方法を示す断面図（その 1）である。

【図 4】第 1 の実施形態に係る配線基板の製造方法を示す断面図（その 2）である。

【図 5】第 1 の実施形態に係る配線基板の製造方法を示す断面図（その 3）である。

【図 6】第 1 の実施形態に係る配線基板の製造方法を示す断面図（その 4）である。

【図 7】第 1 の実施形態に係る配線基板の製造方法を示す断面図（その 5）である。

【図 8】第 1 の実施形態に係る配線基板の製造方法を示す断面図（その 6）である。

【図 9】第 2 の実施形態に係る配線基板の製造方法を示す断面図（その 1）である。

【図 10】第 2 の実施形態に係る配線基板の製造方法を示す断面図（その 2）である。

【図 11】第 3 の実施形態に係る半導体パッケージを示す断面図である。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 6 5

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 6 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 6 6】

(第3の実施形態)

次に、第3の実施形態について説明する。第3の実施形態は半導体パッケージに関する。図1\_1は、第3の実施形態に係る半導体パッケージ500を示す断面図である。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0067

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0067】

図1\_1に示すように、第3の実施形態に係る半導体パッケージ500は、第1の実施形態に係る配線基板100、半導体チップ300、 bumps 312、アンダーフィル樹脂330及び外部接続端子331を有する。

【手続補正5】

【補正対象書類名】図面

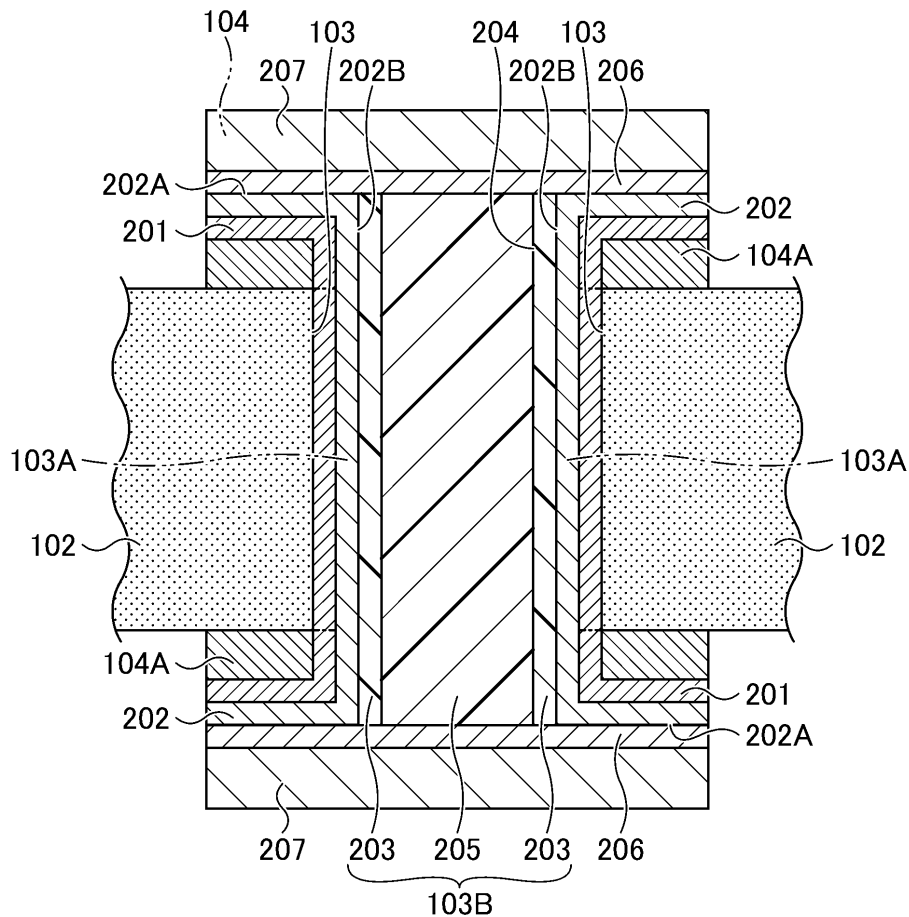
【補正対象項目名】図2

【補正方法】変更

【補正の内容】

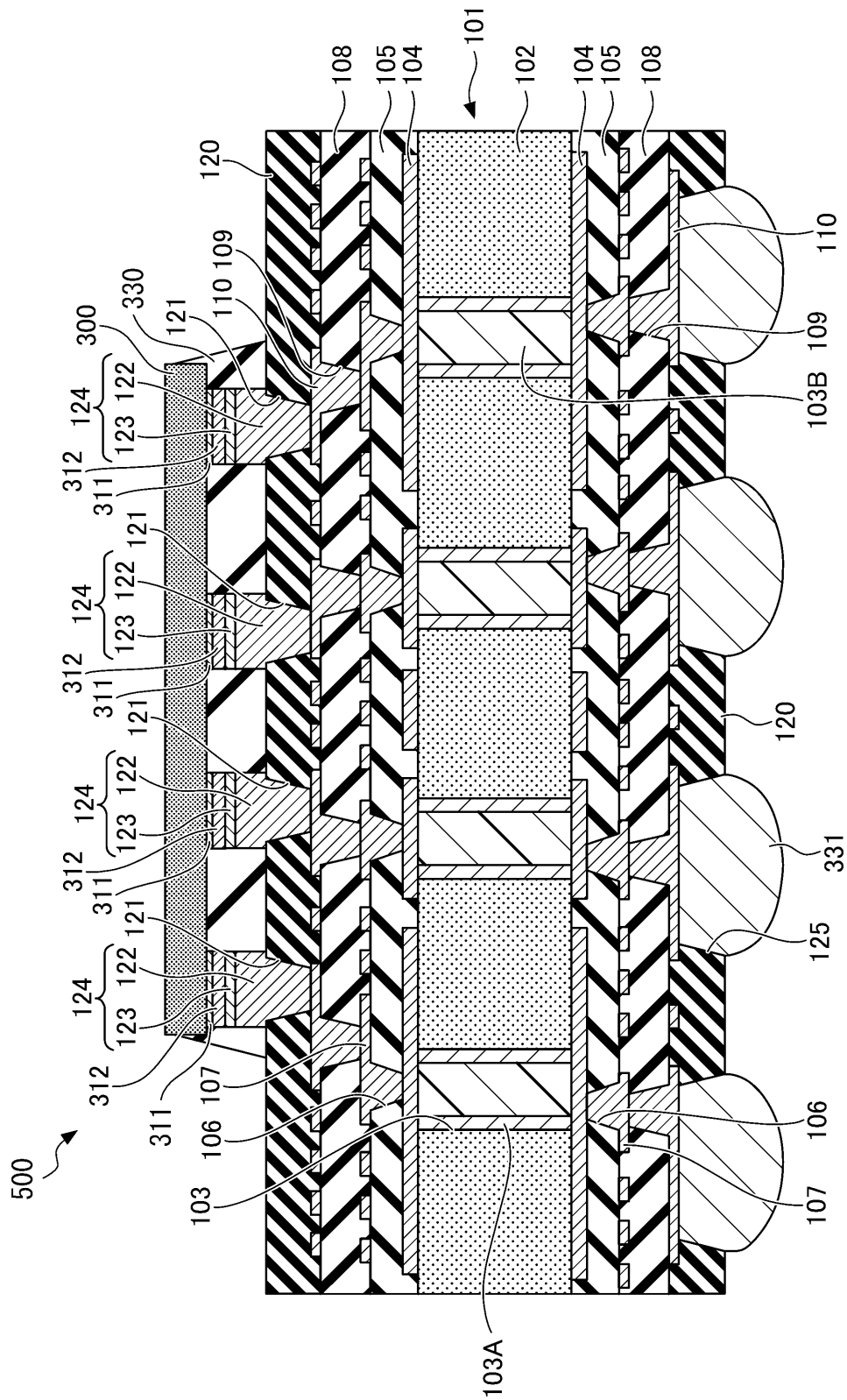
【図2】

導電層、充填材及び第1の配線層を示す断面図



【手続補正6】

【補正対象書類名】図面  
【補正対象項目名】図 1 1  
【補正方法】変更  
【補正の内容】



【手続補正 7】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図 1 2

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正 8】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図 1 3

【補正方法】削除

【補正の内容】